





PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE  
ENGLISH

【4. 性能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	ダミーカード <sup>*4</sup> を嵌合させ、開放電圧 20mV以下、 短絡電流 10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate dummy card, measure by dry circuit, 20mV MAXIMUM, 10mA MAXIMUM. (JIS C5402 5.4)	100 milliohms MAXIMUM (ターミナル、スイッチ TERMINAL AND SWITCH)
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に DC 500V を印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Apply 500V DC between adjacent terminals or terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Megohms MINIMUM
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に AC 500V (実効値)を1分間印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Apply 500V AC for 1 minute between adjacent terminals or terminal and ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異常なきこと No Breakdown

<sup>\*4</sup>. ダミーカードは、当社製評価用基板を示す。(全項目に適用のこと)

The dummy card shows the P.C.Board for the evaluation made of our company.

また、本ダミーカード寸法は、“microSD Memory Card Specification”に準拠する。

The size of dummy card is based upon “microSD Memory Card Specification”.

REVISE ON PC ONLY

**A**

SEE SHEET 1 OF 12

TITLE:

microSD CARD CONNECTOR  
(PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE)

**製品仕様書**

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO  
MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

**PS-502702-001**

FILE NAME

PS502702001.doc

SHEET

2 of 12

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE  
ENGLISH

4 - 2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-2-1	ターミナル保持力 Terminal Retention Force	毎分 25±3 mmの速さでターミナルを引き抜く。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25 ± 3 mm / minute on the terminal assembled in the housing.	0.49 N MINIMUM	
4-2-2	検知端子保持力 Switch Terminal Retention Force	毎分 25±3 mmの速さで検知端子を引き抜く。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25 ± 3 mm / minute on detect and switch terminals assembled in the housing.	0.49 N MINIMUM	
4-2-3	カード保持力 Card Retention Force	毎分 25±3 mmの速さでロック状態の実物カード <sup>*5</sup> を引き抜く。 Pull the actual card at the speed rate of 25 ± 3 mm / minute in lock condition.	初期値 Initial value 0.8 N MINIMUM	
4-2-4	ロック力及び 解除力 Lock / Unlock Force	毎分 25±3 mmの速さで実物カードを押す。 ロック荷重とロック解除荷重を示す。 Push the actual card at the speed rate of 25 ± 3 mm / minute. Show lock and lock release force.	カムロック力 Lock Force	10 N Maximum
			カムロック解除力 Lock Release Force	10 N Maximum
4-2-5	カード押込強度 (正方向) Push in Strength (Appropriate direction)	ダミーカードを正方向に挿入し、14.7Nの荷重を1秒1回加える。その後、正方向に挿入をする。 Dummy card is inserted in appropriate direction and the load of 14.7N is added in once a second. Then insert in appropriate direction.	正常に挿抜できること To Actuate normally	
4-2-6	カード押込強度 (逆方向) Push in Strength (Opposite direction)	ダミーカードを逆方向に挿入し、14.7Nの荷重を1秒1回加える。その後、正方向に挿入をする。 Dummy card is inserted in the opposite direction and the load of 14.7N is added in once a second. Then insert in appropriate direction.	正常に挿抜できること To Actuate normally	
4-2-7	カード押込強度 (裏挿入) Push in Strength (Reverse Insertion)	ダミーカードを裏にして挿入し、14.7Nの荷重を1秒1回加える。カードを裏にした場合は、斜めに挿入した状態で荷重を加える。その後、正方向に挿入をする。 Dummy card is reversed and inserted, and the load of 14.7N is added in once a second. In reversing the card, add load diagonally. Then insert in appropriate direction.	正常に挿抜できること To Actuate normally	

\*5 実物カードとは、最終ユーザーが使用するmicroSD MEMORY CARDを示す。  
(全項目に適用のこと)

Actual card shows microSD MEMORY CARD, which used is end customer.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:  microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE)  <b>製品仕様書</b>
<b>A</b>	SEE SHEET 1 OF 12	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER <b>PS-502702-001</b>	FILE NAME PS502702001.doc	SHEET 3 of 12
---	------------------------------	------------------



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE  
ENGLISH

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Mate / Un-mate	<p>実物カードで1時間に400~600回の速さで挿入・抜去を10,000回繰り返す。挿抜10回毎に5~10分間休止する。問題なければ休止時間を短くすることも可能とする。 エアブローは3秒間行う(乾燥風)。 初回から1,000回は100回毎、1,001回から10,000回は1,000回毎とする。 Insertion and extraction are repeated 10,000 cycles with the actual card at the speed rate of 400 - 600 cycles / hour. After each 10 cycles stop the insertion and rest the connector for 5 to 10 minutes. If there is no problem, it is possible to shorten rest time. Air-blow (dry air) for 3 seconds : At each 100 cycles interval from start to 1,000 cycles, at each 1,000 cycles interval from 1,001 to 10,000 cycles.</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			<p>接触抵抗 (ターミナル、スイッチ) Contact Resistance (TERMINAL AND SWITCH)</p>	<p>変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM ダミーカードで 測定 With the dummy card</p>
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	<p>ダミーカードを嵌合させ、最大許容電流を通电し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)</p>	温度上昇 Temperature Rise	30 ℃ MAXIMUM
4-3-3	耐振動性 Vibration	<p>ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通电状態で、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に掃引割合10~55~10 Hz / 分、全振幅1.52mmの振動を各2時間 加える。 Amplitude : 1.5mm P-P Sweep time : 10~55~10Hz in 1 minute Duration : 2 hours in each X, Y, Z axes (MIL-STD-202試験法 201) Mate dummy card and subject to the following vibration conditions passing DC 1 mA current during the test. Amplitude : 1.5mm P-P Sweep time : 10~55~10Hz in 1 minute Duration : 2 hours in each X, Y, Z axes (MIL STD-202 Method 201)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			<p>接触抵抗 (ターミナル、スイッチ) Contact Resistance (TERMINAL AND SWITCH)</p>	<p>変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM</p>
			瞬断 Discontinuity	1 microsecond MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:  microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE)  <b>製品仕様書</b>
<b>A</b>	SEE SHEET 1 OF 12	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER <b>PS-502702-001</b>	FILE NAME PS502702001.doc	SHEET 4 of 12
---	------------------------------	------------------



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE  
ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-4	耐衝撃性 Shock	ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向(6面) に、490 m/s <sup>2</sup> の衝撃を 各3回加える。 (IEC 512-4-6c) Mate dummy card and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axis ( 6 side ), passing DC 1 mA current during the test. (Total of 18 shocks) Test pulse: Half Sine Peak value: 490 m/s <sup>2</sup> Duration: 11 ms (IEC 512-4-6c)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 (ターミナル、スイッチ) Contact Resistance (TERMINAL AND SWITCH)	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
			瞬 断 Discontinuity	1 microsecond MAXIMUM
4-3-5	落下衝撃 Fall Down Test	コネクタを150gのダミー筐体に取り付け、高さ150cmの位置から6面を1サイクルとして、3サイクル落下させる。ダミーカードを嵌合させ、カード抜け防止用の蓋等を設置する。 Mount the connector in the dummy case of 150g and drop from height of 150cm. 3 times shall be applied along 3 mutually perpendicular axes. Mate dummy card and set up the lid for the card omission prevention etc.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-6	温度サイクル Temperature Cycling	ダミーカードを嵌合させ、-55±3°Cに30分、+85±2°Cに30分、これを1サイクルとし5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は3分以内とする。試験後、1～2時間室温に放置する。 (JIS C0025) Mate dummy card and subjected to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 1cycle a) -55±3°C 30 min. b) +85±2°C 30 min. Transit time shall be within 3 min. (JIS C0025)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 (ターミナル、スイッチ) Contact Resistance (TERMINAL AND SWITCH)	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:  microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE)  <b>製品仕様書</b>
<b>A</b>	SEE SHEET 1 OF 12	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER <b>PS-502702-001</b>	FILE NAME PS502702001.doc	SHEET 5 of 12
---	------------------------------	------------------



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE  
ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-7	耐熱性 Heat Resistance	<p>ダミーカードを嵌合させ、85±2℃の雰囲気 96時間放置後取り出し、1～2時間室温に放置す る。 (JIS C60068-2-2 / MIL-STD-202 試験方法108) Mate dummy card and exposed to 85±2℃ for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2 / MIL-STD-202 Method 108)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 (ターミナル、スイッチ) Contact Resistance (TERMINAL AND SWITCH)	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-8	耐寒性 Cold Resistance	<p>ダミーカードを嵌合させ、-40±2℃の雰囲気 96時間放置後取り出し、1～2時間室温に放置す る。 (JIS C60068-2-1) Mate dummy card and exposed to -40±2℃ for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 (ターミナル、 スイッチ) Contact Resistance (TERMINAL AND SWITCH)	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-9	耐湿性 Humidity	<p>ダミーカードを嵌合させ、60±2℃、相対湿度 90～95%の雰囲気中に96時間放置後取り出し、 1～2時間室温に放置する。 Mate dummy card and subject to the conditions of 60±2℃, relative humidity 90-95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 (ターミナル、スイッチ) Contact Resistance (TERMINAL AND SWITCH)	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohms MINIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:  microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE)  <b>製品仕様書</b>
<b>A</b>	SEE SHEET 1 OF 12	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER <b>PS-502702-001</b>	FILE NAME PS502702001.doc	SHEET 6 of 12
---	------------------------------	------------------



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE  
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-10	塩水噴霧 Salt Spray	ダミーカードを嵌合させ、35±2℃にて5±1%重量比の塩水を48時間噴霧し試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (MIL-STD-1344) Mate dummy card and exposed to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1% Spray time: 48 hours Ambient temperature: 35±2℃ (MIL-STD-1344)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 (ターミナル、スイッチ) Contact Resistance (TERMINAL AND SWITCH)	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-11	亜硫酸ガス SO <sub>2</sub> Gas	ダミーカードを嵌合させ、40±2℃、相対湿度75%にて25±5ppmの亜硫酸ガス中に96時間放置する。 Mate dummy card and expose to 25±5 ppm SO <sub>2</sub> gas, ambient temperature 40±2℃, relative humidity 75% for 96 hours.	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 (ターミナル、スイッチ) Contact Resistance (TERMINAL AND SWITCH)	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-12	半田付け性 Solderability	端子先端より0.2mmの位置まで245±5℃の半田に3±0.5秒浸す。 Dip solder tails into the molten solder (held at 245±5℃) up to 0.2mm from the tip of tails for 3±0.5 sec.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の 90%以上 90% of immersed area must show no voids, Pinholes
4-3-13	半田耐熱性 Resistance to soldering Heat	第6項参照 2回実施 半田ペースト: Sn-3.0Ag-0.5Cu その後、半田ごてを350±5℃で5±0.5秒間ターミナルおよび金具にあてる。 Refer to paragraph 6. Two times. Solder paste : Sn-3.0Ag-0.5Cu After, touch the terminals and nails with soldering iron (held at 350±5℃) for 5±0.5 seconds by 2 times. However, without too much pressure to the terminals and nails.	外観 Appearance	端子ガタ、割れ等 異常なきこと No Damage after 2 times of reflow

REVISE ON PC ONLY		TITLE: microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE) <b>製品仕様書</b>
<b>A</b>	SEE SHEET 1 OF 12	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER <b>PS-502702-001</b>	FILE NAME PS502702001.doc	SHEET 7 of 12
---	------------------------------	------------------



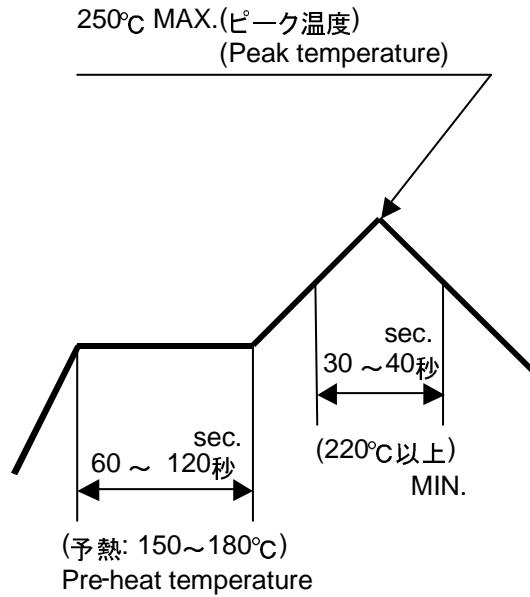
【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照

Refer to the drawing.

【6.リフロー条件 REFLOW CONDITION】

温度条件グラフ  
TEMPERATURE CONDITION GRAPH



注記  
NOTES

1.本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なります。  
事前の実装評価(リフロー評価)の御確認を御願い致します。

This reflow condition may change by the actual reflow machine, p.c.boards, and so on.  
Please check soldering appearance by using your own reflow condition before production  
because there is a possibility of solder wicking.

2.温度条件は、半田接合部とする。  
Let temperature conditions be the solder joint of connector.

推奨メタルマスク厚さ : t=0.12mm  
Thickness of METAL MASK  
メタルマスク開口率 : 100%  
Open aperture ratio

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>A</b>	SEE SHEET 1 OF 12	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE)	
	REV.	DESCRIPTION	製品仕様書 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER <b>PS-502702-001</b>		FILE NAME PS502702001.doc	SHEET 8 of 12





【7.使用上の注意事項 INSTRUCTION UPON USAGE】

7-1. カード抜け防止

Card omission prevention

本品にはカード抜け防止用の簡易ロックをスライダーカムに設けていますが、カードを嵌合した状態で落下させたり、衝撃を加えるとカードが抜けてきます。従って、筐体にカード抜け防止用の蓋等を設置してください。その場合、カードロック状態でのカードと蓋等の隙間は0.3mm以下にしてください。

The card is dropped while having engaged or the impact is added and the card comes off to this item though a simple lock for the card omission prevention is installed in the slider cam.

Therefore, please set up the lid for the card omission prevention etc. in the enclosure.

In that case, please adjust the spaces such as cards and lids in the state of the card lock to 0.3 mm or less.

7-2. 半田付け後の洗浄

Washing after soldering

本品を半田付け後に洗浄をする場合は、半田付け部のみ部分的に洗浄を行ってください。

ジャブ漬け等の洗浄をした場合は、カードの挿入、抜去が困難になる場合があります。

Please wash only the soldering part partially when washing after this item is soldered.

When a whole soaking etc. are washed, the insertion and extraction of the card might become difficult.

7-3. セットへの組み込み後、コネクタに直接大きな振動及び負荷等が加わらない様に、取り付け基板に固定対策をして下さい。

After mounting of connectors, connectors shall be fastened to printed circuit boards where connectors are mounted so that connectors are free from direct excessive vibration and force.

7-4 コネクタ接触部には触れないで下さい。

Contacts of connectors shall be kept from human touch.

7-5. 本仕様書記載のリフロー条件に従って実装を行って下さい。

Please mounting connectors follow to reflow condition given this specification.

7-6. 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に、注意して下さい。

After mounting of connectors, please care of not pile up on printed circuit boards, which mounted connectors directly.

7-7. カードの裏表の逆挿しをするとカードが抜けない、またはコネクタが破損する恐れがあります。破損防止のためにもカードの向き・方向の表示を実機側でもお願い致します。

If the both side of a card is put in conversely, a card will not pull out, and connector may be damaged.

The direction and the direction of a card are displayed on a system side for breakage prevention.

7-8. FPCへの実装

Mounting on the FPC

コネクタの反り防止のため、実装時及び実使用時はFPCの下または周辺に補強版を入れコネクタを固定して下さいませ様ご配慮願います。また、別途ご相談願います。

In case you are mounting the connector on the FPC, please attach the backup below the FPC in order to prevent the connector from warping.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>A</b>	SEE SHEET 1 OF 12	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE)	
		<b>製品仕様書</b>	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-502702-001</b>		FILE NAME PS502702001.doc	SHEET 9 of 12
EN-37-1(019)			



7-9. カードの無理抜き

Card Extraction with force

コネクタ内でカードがロックされた状態で、カードを無理に引き抜かないようにして下さい。  
内部を破損する恐れがあります。

In case the card is locked position, please do not extract the card with force in order to prevent the inside of connector from damaging.

7-10. カード挿入、抜去時に図面記載のカード押し込み寸法まで確実に押すように考慮した筐体デザインにしてください。

Please make sure to design your phone chassis which push the card head to maintain "card lock position" dimension on our drawing when inserting and extracting the card.

7-11. カードを実装した状態、或いはカード無理抜き等によるカムスライダーをロックした状態にて、リフロー等加熱はしないで下さい。加熱によるストレスによりカードロック機構は破損する恐れがあります。

Please do not apply heat while the card is inside of the socket or CAM slider is still locked position by manual card extraction. The heat and stress may cause to the damage card lock mechanism.

7-12. 繰り返し挿抜を連続的に実施した際、カード磨耗により排出がされない場合があります。

この場合カードの清掃を行い排出が確認できれば、コネクタとしては良品と判断しております。

Discharge may not be carried out by card friction when repetition insertion and remove is carried out continuously. In this case, if a card is cleaned and discharge can be checked, as a connector, it will be judged as the excellent article.

7-13. コネクタに直接力が加わると、コネクタの変形を起こす可能性やカード排出性に影響がございます。コネクタ上面から筐体までにコネクタMAX高さから十分なクリアランスを設けてください。コネクタに直接力が加わる時は別途ご相談をお願いします。

When this item is shocked and pressurized hard, there is possibility to occur deformity and card sticking. Therefore, please make suitable clearance on the top of MAX height connector. If your phone design can't prevent from damaging connector, please confirm it.

7-14. 適合カードは規格内カードとしカードの厚みはコンタクト部0.8mm MAX. (反りを含む)とする。

The application card is in spec card .

The thickness of the card is 0.8mm MAX. in contact area (included warpage)

7-15. 衝撃時・負荷時におけるカード検知スイッチの電気的性能

Electrical Performance of Detect Switch to hard shock

本品に強い衝撃や強い負荷が加わると、瞬間的にカード検知スイッチとシェルが同電位になることが有ります。

Electric potential of Detect Switch is equal to it of Shell for an instant, when this item is shocked and pressurized hard.

REVISE ON PC ONLY

**A**

SEE SHEET 1 OF 12

TITLE:

microSD CARD CONNECTOR  
(PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE)

**製品仕様書**

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

**PS-502702-001**

FILE NAME

PS502702001.doc

SHEET

10 of 12



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE  
ENGLISH

7-16. 半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタの基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部(計14ヶ所)に半田付けを行って下さい。

As for the non-solder of a solder mounting part are anxious about terminal omission, short-circuit between pins, terminal bend, and the blank from the substrate of a connector.

Therefore, please solder to all terminal tail parts and Neil parts (total of 14 places).

7-17. 本製品はカード飛び出し制御に重点を置いており、カード排出がされない場合があります。

この場合、カードの姿勢を変化させる、再度押すなどの処置を行い、排出が確認できれば、コネクタとしては良品と判断しております。

As for this product, it gives priority to the card dashing out control, and the card discharge might not be done.

In this case, if the following treatments are given and discharge cab be checked, as a connector, it will be judged as the excellent article. 1.The posture of the card is changed. 2.The card is pushed several times.

3.etc.

7-18. コネクタに短時間に過度な衝撃を加えると変形を起こす可能性がございます。コネクタへの過度な衝撃が加わらないように考慮した筐体デザインにさせていただきますようお願いいたします。

There is possibility to occur deformity, when the connector is over-shocked for a short time. Please make sure design your phone chassis, to be free from over-shock to connector.

【8.環境指令への適合 COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL DIRECTIVE】

1. ELV及びRoHS適合品

ELV and RoHS Compliant

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>A</b>	SEE SHEET 1 OF 12	microSD CARD CONNECTOR (PUSH/PUSH & NORMAL LOW-PRO TYPE)	
		<b>製品仕様書</b>	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-502702-001</b>		FILE NAME PS502702001.doc	SHEET 11 of 12
EN-37-1(019)			

